

자동 고압 핫 프레스 90톤 300X300Mm 플래튼 0.2% 압력 정확도 200°C

품목 번호: XP65



소개

300×300 mm 플래튼에 90톤의 힘을 제공하며 0.2%의 압력 정확도와 최대 200°C까지의 정밀한 PID 온도 제어를 갖춘 자동 고압 핫 프레스를 발견하세요. 배터리 연구, 반도체 패키징, 폴리머 성형 및 복합재료 밀실화에 이상적입니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
고체 배터리 라미네이션	고압 하에서 전극 및 고체 전해질 층을 압축하여 계면 저항을 줄이고 이온 전도도 및 셀 성능을 향상시킵니다. 단단계 압력 프로파일을 통해 섬세한 소재를 손상시키지 않고 최적화된 라미네이션 사이클이 가능합니다.	90톤 힘으로 결합 없는 계면 달성.
반도체 패키징	최대 200°C까지의 제어된 온도에서 대형 기판, 다이 또는 캡슐화 소재의 정밀 열압 접합을 수행합니다. 균일한 압력은 고급 패키징 기술에 중요한 신뢰할 수 있고 공극 없는 접합을 보장합니다.	일관된 접합 무결성 및 평탄도.
폴리머 성형	고클램프력과 일정한 열 하에서 엔지니어링 플라스틱, PTFE, 폴리에틸렌 및 고무 시트를 성형 및 경화합니다. 프로그래밍 가능한 사이클은 반복 가능한 부품 품질과 치수 정확도를 보장합니다.	고밀도, 치수 정확한 부품.
복합재료 밀실화	단단계 열 및 압력 프로파일을 사용하여 섬유 강화 복합재료, 프리프레그 및 라미네이트를 통합하여 공극을 제거하고 섬유 체적 분율을 증가시킵니다.	향상된 기계적 강도 및 내구성.
세라믹 기판 라미네이션	LTCC/HTCC 모듈용 다층 세라믹 그린 테이프를 프레스하여 균일한 두께와 접착력을 보장합니다. 균등한 압력 분포는 균열 및 박리를 방지합니다.	신뢰할 수 있는 기판의 높은 수율 생산.
연료전지 MEA 조립	PEM 연료전지용 멤브레인 전극 어셈블리를 핫 프레스하여 정밀한 온도와 압력 하에서 촉매층을 멤브레인에 접합하여 삼상 경계를 최적화합니다.	최적화된 성능 및 내구성.
스퍼터링 타겟 접합	고압과 열을 사용하여 스퍼터링 타겟을 백킹 플레이트에 접합하여 열 사이클링을 견딜 수 있는 강력하고 전도성 계면을 보장합니다.	공극 또는 핫스팟 없는 신뢰할 수 있는 접합.
접착제 라미네이션	광학 또는 항공우주 부품용 금속 및 유리과 같은 이종 소재 사이의 구조용 접착제를 제어된 힘과 열을 사용하여 경화합니다.	기포 없는 강력하고 광학적으로 투명한 접합.

매개변수	사양	비고
모델	XP65-90T3030	고압 자동 핫 프레스
최대 힘	0 - 90톤 (900 kN)	안정적인 힘 적용을 위한 PIDS 패시브 루프 유압 제어
압력 센서 정확도	±0.2%	고정밀 센서로 최소 압력 드리프트 보장
작동 온도	0 - 200 °C (최대 200°C)	최대 200°C까지 열 대칭성 및 평탄도 최적화
온도 제어	PID 프로그래밍 가능 컨트롤러	단단계 프로그래밍을 위한 7인치 컬러 터치스크린 인터페이스
가열 출력	3500 W	낮은 열 손실을 갖춘 효율적인 가열
플래튼 크기	300 × 300 mm	최대 300×300 mm 샘플에 적합
최대 표면 압력	~100 Bar (10 MPa)	전체 플래튼 영역에 걸쳐 90톤에서 달성

매개변수	사양	비고
전원 공급	AC 220V / 50Hz (단상)	안전한 작동을 위해 전용 16A 회로 필요
치수 (가로×세로×높이)	600 × 520 × 650 mm	컴팩트한 벤치탑 풋프린트
무게	350 kg	강성을 위한 중장비 구조; 실험대 지지 확인 필요